

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0522)

截至二零二四年三月三十一日止三個月之 二零二四年第一季度未經審核業績公布

訂單對付運比率高於一
先進封裝推動新增訂單總額按季增長

集團財務概要: 二零二四年第一季度

- * 銷售收入為港幣 31.4 億元(4.01 億美元)，按年-19.9%，按季亦-7.8%
- * 新增訂單總額為港幣 32.0 億元(4.09 億美元)，按年-9.8%，按季則+17.0%
- * 毛利率為 41.9%，按年+145 點子，按季則-40 點子
- * 經營利潤率為 7.6%，按年-425 點子，按季則+218 點子
- * 盈利為港幣 1.77 億元，按年-43.7%，按季則+134.5%
- * 每股基本盈利為港幣 0.43 元，按年-44.2%，按季則+138.9%

非香港財務報告準則計量¹

- * 經調整盈利為港幣 1.77 億元，按年-43.7%，按季則+132.1%
- * 經調整每股基本盈利為港幣 0.43 元，按年-44.2%，按季則+138.9%

二零二四年第二季度銷售收入預測

- * 將介乎 3.8 億美元至 4.4 億美元之間，以其中位數計按年-17.6%，按季則+2.2%

¹ 於二零二四年第一季度及二零二三年第一季度皆無相應的非香港財務報告準則調整。有關非香港財務報告準則計量之詳情，請參閱「香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬」章節。

ASMPT Limited 董事會欣然宣布集團截至二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核業績如下：

業績摘要

ASMPT Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零二四年三月三十一日止三個月（「二零二四年第一季度」）錄得銷售收入為港幣31.4億元(4.01億美元)，按年減少19.9%。集團於二零二四年第一季度綜合除稅後盈利為港幣1.77億元，去年度同期盈利則為港幣3.15億元。二零二四年第一季度的每股基本盈利為港幣0.43元，而二零二三年第一季度的每股基本盈利為港幣0.77元。

管理層討論及分析

二零二四年第一季度業務回顧將由集團表現最顯著的業務亮點開始解說，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部（「SEMI」）及表面貼裝技術解決方案分部（「SMT」）的財務回顧。

二零二四年第一季度集團業務摘要

經過七個季度，集團的訂單對付運比率於二零二四年第一季度升至一以上。集團於第一季度錄得新增訂單總額增長，是因兩個分部的新增訂單總額均較二零二三年第四季度有所增加。半導體解決方案分部新增訂單總額的按季增長主要由低基數效應推動。表面貼裝技術解決方案分部的新增訂單總額經過二零二三年下半年的放緩後，已開始趨於穩定，主要由汽車及工業終端市場所推動。

第一季度的新增訂單總額增長主要受對集團的先進封裝（「AP」）解決方案的需求所推動。集團的互連解決方案包括熱壓焊接（「TCB」）、混合式焊接（「HB」）及覆晶（「FC」）高精度固晶，主要受人工智能推動。連同表面貼裝技術解決方案分部的系統封裝（「SiP」）先進封裝工具，這些均對集團於二零二四年第一季度的先進封裝新增訂單總額作出很大貢獻。

集團銷售收入達到預測的中位數，其中來自表面貼裝技術解決方案分部的佔比較高。這突顯了集團獨有的廣泛產品組合的優勢，因為兩個分部遵循不同的業務周期。

從終端市場的角度來看，集團的汽車應用繼續佔集團總銷售收入的最高比例。儘管汽車市場表現疲軟，集團表面貼裝技術解決方案分部於該市場的工具銷售收入仍按季錄得增長。此外，半導體解決方案分部的汽車解決方案亦受益於供應鏈的某些專業技術領域，例如能源及碳化矽模組，以及高端汽車智能車頭燈。

先進封裝

先進封裝繼續成為集團的亮點，由於集團擁有業界最全面的先進封裝解決方案，可以服務多種應用的方案，因而處於領先地位以把握來自生成式人工智能及高性能計算（「HPC」）應用不斷增長的需求。

集團於第一季度繼續獲得來自垂直整合製造商及外判半導體裝嵌及測試客戶用於邏輯應用的TCB訂單。

集團於二零二三年下半年獲得領先晶圓代工客戶用於晶片到基底（「C2S」）應用的重要TCB訂單，並已開始向其付運TCB工具。為進一步支持客戶因生成式人工智能而增加的對先進封裝需求，集團預期於第二季度及以後將獲得更多來自此領先晶圓代工客戶及其供應鏈合作夥伴應用於晶片到基底的TCB訂單。此外，關於晶片到晶圓（「C2W」）應用，集團最近向該晶圓代工客戶交付了下一代超微間距TCB工具，以作共同開發之用，並對未來數季繼續將獲得晶片到晶圓TCB訂單充滿信心。

管理層討論及分析（續）

在高頻寬記憶體（「HBM」）方面，集團的 TCB 工具已於一間領先的高頻寬記憶體公司投入生產，應用於 12 層堆疊，並已向另一間高頻寬記憶體客戶交付了演示工具，未來還有更多工具亦在生產籌劃之中。此外，隨著高頻寬記憶體行業的最新發展，TCB 因其高性價比，成為了 12 層、16 層及以上堆疊要求的首選解決方案。

集團對其 TCB 解決方案在精確度、處理薄或者大的晶片的能力以及深厚的工藝認知方面的優勢保持信心。隨著邏輯及高頻寬記憶體應用加速採用 TCB，使集團處於有利地位。

就混合式焊接而言，集團於第一季度獲得另外兩份邏輯應用的工具訂單。集團有信心在未來將能獲得更多混合式焊接的訂單。

表面貼裝技術解決方案分部的先進封裝工具的新增訂單總額按季錄得增長，主要得益於其系統封裝工具，其需求主要來自全球領先廠商的高端智能手機和可穿戴設備，以及個人電腦和伺服器相關應用的射頻模組所推動。

二零二四年第一季度集團財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	3,199.9 (4.09 億美元)	+17.0%	-9.8%
銷售收入	3,138.8 (4.01 億美元)	-7.8%	-19.9%
毛利率	41.9%	-40 點子	+145 點子
經營利潤率	7.6%	+218 點子	-425 點子
經調整盈利	177.5	+132.1%	-43.7%
經調整盈利率	5.7%	+341 點子	-239 點子

二零二四年第一季度的銷售收入為港幣 31.4 億元（4.01 億美元），達上一次發布的預測中位數。由於半導體解決方案分部和表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入均下降，導致銷售收入按季下降 7.8%，再加上半導體持續下行周期，使半導體解決方案分部的下降幅度更大。

受惠於對半導體解決方案分部及表面貼裝技術解決方案分部對先進封裝解決方案的殷切需求，集團新增訂單總額按季增長 17.0% 至港幣 32.0 億元（4.09 億美元）。於二零二四年三月三十一日，集團的未完成訂單總額保持穩定，約為 8.49 億美元。

集團的毛利率按季微跌 40 點子至 41.9%，主要由於表面貼裝技術解決方案分部的毛利率下降，但部分已被半導體解決方案分部毛利率的增幅所抵銷。

集團的經營利潤率按季增長 218 點子至 7.6%，主要由於持續的成本管控措施及季節性因素導致營運費用下降所致。

集團的經調整盈利為港幣 1.77 億元，按季上升 132.1%。

集團的資產負債表保持穩健，於二零二四年三月三十一日的現金及銀行存款結存錄得港幣 52.5 億元（二零二三年十二月三十一日：港幣 48.0 億元）。於二零二四年三月三十一日，集團的淨現金為港幣 27.5 億元（二零二三年十二月三十一日：港幣 28.0 億元）。

管理層討論及分析（續）

二零二四年第一季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	1,555.6 (1.99 億美元)	+25.1%	+3.5%
銷售收入	1,375.3 (1.76 億美元)	-13.7%	-10.8%
毛利率	44.6%	+86 點子	-46 點子
分部盈利	0.2	-83.6%	-99.6%
分部盈利率	0.01%	-5 點子	-246 點子

半導體解決方案分部於第一季度的銷售收入為港幣 13.8 億元(1.76 億美元)，按季下降 13.7%，佔集團季度總銷售收入約 44%。該分部的銷售收入表現主要受其業務單位以下發展影響：

- (i) 集成電路/離散器件業務單位的銷售收入按季下降主要因為集團的沉積設備受行業疲弱所影響。然而，與消費者相關的主流工具業務接獲零星需求。
- (ii) 光電業務單位的銷售收入按季下降。該業務單位銷售收入主要來自高端汽車車頭燈及光子相關應用。
- (iii) CIS 業務單位的銷售收入因基數較低而按季錄得增長，主要由於高端智能手機市場。

半導體解決方案分部的新增訂單總額為港幣 15.6 億元（1.99 億美元），由於基數較低按季增長 25.1%，主要受益於消費者及電腦終端市場。先進封裝亦錄得按季增長。

儘管銷量較低，分部毛利率於第一季度改善至 44.6%，按季上升 86 點子，主要受惠於銷售先前已撥備的庫存而產生的一次性收益。

二零二四年第一季度表面貼裝技術解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二四年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	1,644.3 (2.10 億美元)	+10.1%	-19.5%
銷售收入	1,763.5 (2.26 億美元)	-2.6%	-25.8%
毛利率	39.7%	-123 點子	+233 點子
分部盈利	290.1	+8.8%	-39.6%
分部盈利率	16.5%	+172 點子	-375 點子

於第一季度，表面貼裝技術解決方案分部連續第七個季度錄得比半導體解決方案分部高的銷售收入，佔集團總銷售收入約 56%。表面貼裝技術解決方案分部於第一季度錄得銷售收入港幣 17.6 億元（2.26 億美元），按季微跌 2.6%。汽車及工業應用仍然是表面貼裝技術解決方案分部銷售收入的主要來源，需求主要來自歐洲。

表面貼裝技術解決方案分部於第一季度的新增訂單總額按季增長 10.1%至港幣 16.4 億元（2.10 億美元），主要受先進封裝及汽車應用的增長所推動。

第一季度的分部毛利率為 39.7%，按季下跌 123 點子，主要受產品組合影響。

管理層討論及分析（續）

前景

集團預期二零二四年第二季度的銷售收入將介乎 3.8 億美元至 4.4 億美元之間，以其中位數計按年下降 17.6%，按季則上升 2.2%。按季輕微增長主要是由於半導體解決方案分部的銷售收入增加，但部份增長將被表面貼裝技術解決方案分部的銷售收入減少所抵銷。

憑藉其獨有的廣泛產品組合，集團對其長遠前景及增長潛力依然保持樂觀，集團的信心亦得到包括汽車電動化、智能工廠、綠色基礎設施、5G/6G、物聯網、和於雲端、數據中心及人工智能邊緣裝置的人工智能增長的長期結構性趨勢所支持。從更廣泛的層面來看，這些結構性趨勢與兩個關鍵領域的持續增長相互呼應：一方面，個別國家增加資本性開支加強本土化從而保護其供應鏈；另一方面，企業正為應對更多變的全球供應鏈，支持日益數碼化的互聯世界，做好準備。

簡明綜合損益表

	截至 二零二四年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
	<i>附註</i>		
銷售收入	2	3,138,783	3,404,694
銷貨成本		(1,824,407)	(1,965,491)
毛利		<u>1,314,376</u>	<u>1,439,203</u>
其他收入		49,086	57,810
銷售及分銷費用		(358,811)	(423,276)
一般及行政費用		(257,085)	(276,712)
研究及發展支出		(458,682)	(553,438)
其他收益及虧損, 淨值		18,262	(24,279)
其他支出		(9,102)	(22,289)
財務費用		(42,186)	(52,261)
合營公司業績持份		5,259	(18,856)
除稅前盈利		<u>261,117</u>	<u>125,902</u>
所得稅開支		(83,662)	(129,262)
本期間盈利		<u><u>177,455</u></u>	<u><u>75,679</u></u>
以下各方本期間應佔盈利(虧損):			
本公司持有人		179,913	75,351
非控股權益		(2,458)	328
		<u><u>177,455</u></u>	<u><u>75,679</u></u>
每股盈利	3		
- 基本		<u>港幣 0.43 元</u>	<u>港幣 0.18 元</u>
- 攤薄		<u>港幣 0.43 元</u>	<u>港幣 0.77 元</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二四年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	177,455	75,679	315,128
其他全面(支出)收益			
<i>不會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 界定福利退休計劃的除稅後重新計量	-	16,630	-
- 其他全面收益以公平價值列賬的權益 性工具投資之公平價值(減值)收益 淨額	(280)	535	245
<i>其後可能會被重新分類至損益的項目:</i>			
- 換算海外營運公司匯兌差額:			
- 附屬公司	(156,902)	319,023	247,285
- 合營公司	804	3,991	12,582
- 被指定對沖現金流的對沖工具之 公平價值減值	(15,656)	(14,622)	(17,201)
本期間其他全面(支出)收益	(172,034)	325,557	242,911
本期間全面收益總額	5,421	401,236	558,039
以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額:			
本公司持有人	7,924	398,989	557,495
非控股權益	(2,503)	2,247	544
	5,421	401,236	558,039

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團有兩個（二零二三年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二三年：兩個）主要產品系列。

集團以可報告之經營分部分析銷售收入和業績如下：

	截至 二零二四年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
對外客戶分部銷售收入			
半導體解決方案	1,375,296	1,594,198	1,541,099
表面貼裝技術解決方案	1,763,487	1,810,496	2,376,394
	3,138,783	3,404,694	3,917,493
分部盈利			
半導體解決方案	154	939	38,096
表面貼裝技術解決方案	290,096	266,635	480,114
	290,250	267,574	518,210
利息收入	32,755	28,425	19,295
財務費用	(42,186)	(52,261)	(29,381)
合營公司業績持份	5,259	(18,856)	11,417
未分配其他收入	5,837	4,416	5,186
未分配外幣淨匯兌收益(虧損)及 外幣遠期合約的公平價值變動	16,839	(45,435)	(24,302)
未分配一般及行政費用	(42,844)	(56,334)	(48,416)
未分配其他收益	4,309	20,662	225
其他支出	(9,102)	(22,289)	(7,844)
除稅前盈利	261,117	125,902	444,390
分部盈利之百分比			
半導體解決方案	0.01%	0.1%	2.5%
表面貼裝技術解決方案	16.5%	14.7%	20.2%

3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二四年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之本期間盈利)	179,913	75,351	317,887
	截至 二零二四年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)	截至 二零二三年 十二月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 (未經審核)
計算每股基本盈利之普通股加權平均 股數	414,505	412,554	412,504
潛在攤薄影響之股數：			
- 僱員股份獎勵計劃	3	1,982	2
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均 股數	414,508	414,536	412,506

香港財務報告準則計量與非香港財務報告準則計量之對賬

就財務表現回顧，集團已提供經調整盈利及經調整每股盈利，作為集團根據香港財務報告準則呈列的綜合業績之補充。集團相信，上述額外數據能為股東及投資者提供有關集團持續經營表現的有用補充資料，有助分析及比較各期間的財務趨勢及業績。經調整盈利及經調整每股盈利不包括主要與僱員遣散費用及福利安排有關之重組成本的影響。

採用該等非香港財務報告準則計量作為分析及比較工具或存在一定的局限性。故建議股東及投資者不應將其與集團根據香港財務報告準則所呈報的財務業績分開考慮或視作替代分析。此外，該等非香港財務報告準則計量的定義可能有別於其他公司使用的類似詞彙。

下表載列集團根據香港財務報告準則編製的二零二三年第四季度財務計量與非香港財務報告準則計量的對賬。

	截至二零二三年十二月三十一日止三個月 非香港財務報告準則調整			
	賬列 港幣千元 (未經審核)	重組成本 港幣千元 (未經審核)	所得稅之影響 港幣千元 (未經審核)	經調整 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	75,679	1,110	(334)	76,455
盈利率	2.2%			2.2%
本公司持有人應佔盈利	75,351	1,110	(334)	76,127
每股基本盈利(港幣元)	0.18			0.18

附註：集團於二零二四年第一季度及二零二三年第一季度皆無相應的非香港財務報告準則計量調整。

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二四年三月三十一日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生、鄧冠雄先生、張仰學先生及蕭潔雲女士；非執行董事：盧鈺霖先生及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二四年四月二十三日

(本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)